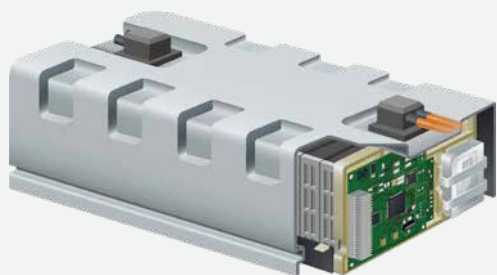


# 基板向け非導電性ペースト

自動車用途等にて 20 年以上に渡る採用実績

## 用途

産業機器・自動車向け基板（高Tg）



イメージ：自動車



家電向け基板（高密度配線）



イメージ：ゲーム機



## 特徴

- 各種基材や銅箔と優れた密着性
- 溶剤不使用のため、ポイドの発生を抑制
- 基板の高密度実装やビルドアップ化に貢献



## ラインナップ&特性

製品型番			AE1125HD	AE1125DS
粘度	BH型	dPa・s	1,200 ~ 2,000	800 ~ 1,600
硬化条件	予備加熱		80°C×30分	
	本硬化		160°C×60分	
体積抵抗率		Ω・cm	1.0E+09 ~ 1.0E+12	
熱伝導性（レーザーフラッシュ法）		W/m・k	1.4	1.1
ガラス転移温度（DMA）		°C	163	210

